



きんぼし
東大阪

超薄板ガラス切断機の スペシャリスト

株式会社 シライテック

〒577-0835

東大阪市柏田西 3-5-21

TEL 06-6728-7615

FAX 06-6728-1444

http://www.shirai-tech.co.jp/



代表取締役社長
白井 博

★創業
1961年(昭和36年)

★資本金
1,200万円

★従業員
110人

★主要営業品目
平板ガラス加工板全般、LCD用
素板切断折り削り

★トップシェア製品
NC自動ガラス切断ライン
LCD用素板自動切断ライン
LCD用カバーガラス切断研磨I
Nライン

「創造は豊かな内容と価値を生む」が(株)シライテックの理念である。単なるひらめきで技術の創造は出来ないが、創立60年来の技術蓄積により、顧客が世に出そうとする新製品に対する加工機の装置提案ができ、次のステップに繋がると考えている。

最近では、携帯電話、パソコン、テレビ、カーナビ等の前面表示パネル及び薄膜太陽電池基板等は全てガラス素材から製品となっており、これから先も益々の需要拡大が見込まれる。これは同社にとってチャンスであり、時代のニーズに即応した省人・省力・合理性を追求し、伝統の中にも革新を取り入れた製品開発で、顧客の要望に応じていきたいと考えている。

第5世代単板用切断・分断・R面取り装置(下記写真、特許第3368246号)は、基板サイズG5世代(1100×1300mm)のガラス基板を切断・分断・エッジ研磨する全自動装置で、強化ガラス、タッチパネル、3Dパネル等、非常に扱い難いガラスも特殊なカッターによりスクライブ・分断。プロセス上で最も避けるべきカレット飛散、スクライブミスによる基板割れ等を防ぎ、客先要求良品率及び最終ユーザーが要求するエッジ強度等もクリアしている。

一方で液晶用基板は通常、2枚のガラスを貼り合わせて1枚の液晶基板となっている。基板サイズ1100×1300mmの大きい基板より、48×75mmの携帯用基板サイズに分断する場合、まずA面をスクライブ後、B面をスクライブするのが一般的であるが、加工工程の中でA面、B面別々の工程でスクライブを行うため、どうしても180度の基板反転が必要となる。特に厚みが0.1～0.3mmの基板を反転する場合、先にスクライブされた面より基板割れが発生し、良品率低下の要因となるが、この問題をクリアした優れた装置が中小型セル基板用無反転切断装置である(特許第3969992号)。

同社は、今後も創業以来の技術の蓄積に革新的技術を取り入れた製品開発で顧客の要望に応じていく。

